



華潤勵致有限公司

China Resources Logic Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1193)

截至二零零七年六月三十日止六個月的中期業績

- 營業額增加50%至24.52億港元。
- 半導體業務營業額增加72%至13.30億港元。
- 半導體業務經營溢利增長32%至1.47億港元。

華潤勵致有限公司（「本公司」或「華潤勵致」）董事會（「董事會」）欣然宣佈本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零零七年六月三十日止六個月期間的未經審核綜合業績連同二零零六年的比較數字如下：

簡明綜合收入報表

截至二零零七年六月三十日止六個月

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零零七年 (未經審核) 千港元	二零零六年 (未經審核) 千港元
營業額	3	2,451,847	1,637,411
銷售成本		(1,933,749)	(1,221,882)
毛利		518,098	415,529
其他收入		64,097	64,224
分銷開支		(103,718)	(53,611)
行政開支		(174,171)	(128,301)
其他開支		(112,513)	(58,921)
經營溢利		191,793	238,920
財務成本		(59,789)	(32,662)
應佔一家聯營公司業績		-	1,103
視作出售一家聯營公司收益		-	1,590
除稅前溢利		132,004	208,951
稅項	4	(20,675)	(24,514)
期內溢利	5	111,329	184,437

應佔:

本公司股本持有人		89,314	142,177
少數股東權益		22,015	42,260
		<u>111,329</u>	<u>184,437</u>
		港仙	港仙
每股中期股息	6	<u>1.00</u>	<u>1.00</u>
每股盈利	7		
基本		<u>3.23</u>	<u>5.33</u>
攤薄		<u>3.18</u>	<u>5.28</u>

簡明綜合資產負債表

於二零零七年六月三十日

		於二零零七年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於二零零六年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備		4,570,805	4,217,639
預付租約款項		174,674	172,559
可供銷售投資		9,906	10,105
商譽		152,777	152,777
技術知識		52,287	53,663
遞延稅項資產		15,133	16,416
購置物業、廠房及設備按金		10,715	63,205
		<u>4,986,297</u>	<u>4,686,364</u>
流動資產			
存貨		1,229,356	1,068,568
應收賬款、按金及預付款項	8	2,279,688	1,622,459
預付租約款項		4,808	4,625
應收少數股東款項		14,380	2,164
可退稅項		490	10,057
已抵押銀行存款		5,999	7,642
銀行結存及現金		547,374	521,250
		<u>4,082,095</u>	<u>3,236,765</u>
資產總值		<u>9,068,392</u>	<u>7,923,129</u>

股本及負債			
資本及儲備			
股本		278,147	276,580
股份溢價及儲備		2,671,552	2,478,511
本公司股本持有人應佔股本		2,949,699	2,755,091
上市附屬公司購股權儲備		8,531	5,805
少數股東權益		1,076,652	1,048,727
股本總值		4,034,882	3,809,623
非流動負債			
借貸		1,629,289	522,306
長期應付款		66,698	66,025
		1,695,987	588,331
流動負債			
應付賬款及應計費用	9	2,346,277	1,648,101
應付少數股東款項		106,895	85,213
借貸		824,172	1,706,617
撥備		45,393	77,111
稅項		14,786	8,133
		3,337,523	3,525,175
負債總值		5,033,510	4,113,506
股本及負債總值		9,068,392	7,923,129
流動資產（負債）淨值			
		744,572	(288,410)
資產總值減流動負債		5,730,869	4,397,954

附註：

1. 編製基準

簡明綜合財務報表已根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）附錄十六的適用披露規定及香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈的香港會計準則第 34 號「中期財務報告」編製。

2. 主要會計政策

簡明綜合財務報表乃按歷史成本編製。

編製簡明綜合財務報表時採納的會計政策與編製本集團於截至二零零六年十二月三十一日止年度的年度綜合財務報表所採納者一致。

於本中期期間，本集團已首次採納由香港會計師公會頒佈而於二零零七年一月一日或之後開始的年度期間生效的新準則、修訂及若干詮釋（「新香港財務申報準則」）。

採納該等新香港財務申報準則對本集團現行或過往會計期間的業績或財務狀況並無構成重大影響。因此並無確認過往期間調整。

本集團並無提早採納由香港會計師公會已頒佈而仍未生效的新及修訂準則或詮釋。本公司董事預期採用此等準則或詮釋將不會對本集團的業績及財務狀況造成重大影響。

3. 業務及地區分類

業務分類

為方便管理，本集團經營業務目前劃分為兩大類：半導體及壓縮機。此等業務乃本集團呈報其主要分類資料的基準。

此等分部的業務如下：

半導體— 設計、製造及封裝集成電路及分立器件

壓縮機— 製造空調壓縮機

截至二零零七年六月三十日止六個月的業績

	半導體 千港元	壓縮機 千港元	綜合 千港元
營業額			
外銷	<u>1,329,469</u>	<u>1,122,378</u>	<u>2,451,847</u>
業績			
分類業績	<u>147,255</u>	<u>56,312</u>	203,567
未分配開支			<u>(11,774)</u>
經營溢利			191,793
財務成本			<u>(59,789)</u>
除稅前溢利			132,004
稅項			<u>(20,675)</u>
期內溢利			<u>111,329</u>

截至二零零六年六月三十日止六個月的業績

	半導體 千港元	壓縮機 千港元	綜合 千港元
營業額			
外銷	<u>770,784</u>	<u>866,627</u>	<u>1,637,411</u>
業績			
分類業績	<u>111,481</u>	<u>135,672</u>	247,153
未分配開支			<u>(8,233)</u>
經營溢利			238,920
財務成本			(32,662)
應佔一家聯營公司業績	1,103	-	1,103
視作出售一家聯營公司收益	1,590	-	1,590
除稅前溢利			<u>208,951</u>
稅項			<u>(24,514)</u>
期內溢利			<u>184,437</u>

地區分類

半導體分部業務於香港及中華人民共和國其他地區（「中國內地」）進行，壓縮機分部業務則於中國內地進行。

下表顯示本集團按地區市場劃分的銷售額分析：

	截至六月三十日止六個月	
	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
中國內地	2,124,288	1,440,780
亞洲（不包括中國）	174,851	120,830
香港	87,175	74,676
其他	65,533	1,125
	<u>2,451,847</u>	<u>1,637,411</u>

4. 稅項

	截至六月三十日止六個月	
	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
本期間稅項		
中國內地	19,366	24,156
遞延稅項	1,309	358
	<u>20,675</u>	<u>24,514</u>

期內，本集團並無在香港產生任何應課稅溢利，故此並無作出香港利得稅撥備。

中國內地產生的所得稅乃根據應課稅溢利按適用稅率計算。

5. 期內溢利

	截至六月三十日止六個月	
	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
期內溢利已扣除（計入）：		
物業、廠房及設備折舊	233,485	121,808
投資物業折舊	-	1,170
技術知識攤銷	2,054	1,569
預付租約款項攤銷	2,403	2,190
存貨撇減至可變現淨值（包括在其他開支內）	26,155	3,613
研究、設計及發展開支（包括在其他開支內）	63,329	34,292
借貸利息開支	59,789	32,662
應佔一家聯營公司稅項（包括在應佔一家聯營公司 業績內）	-	553
撥備撥回，包括在其他收入內	(25,858)	-
銀行利息收入	(3,198)	(2,506)
出售物業、廠房及設備的收益淨額	(6,561)	(2,458)
出售可供銷售投資的收益	(1,924)	-

6. 股息

於二零零六年六月十二日，本公司向股東派付截至二零零五年十二月三十一日止年度的末期股息每股2.0港仙，合共53,406,000港元。

於二零零七年六月五日，本公司向股東派付截至二零零六年十二月三十一日止年度的末期股息每股1.0港仙，合共27,671,000港元。

董事議決宣派中期股息每股1.0港仙（二零零六年：中期股息每股1.0港仙），合共27,815,000港元。

7. 每股盈利

每股基本及攤薄盈利乃按以下數據計算：

	截至六月三十日止六個月	
	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
盈利：		
用以計算每股基本盈利的盈利（本公司股本持有人應佔期內溢利）	89,314	142,177
附屬公司潛在攤薄股份對本集團應佔盈利的影響	(167)	-
用以計算每股攤薄盈利的盈利	<u>89,147</u>	<u>142,177</u>
股份數目：		
用以計算每股基本盈利的加權平均股份數目	2,768,250,640	2,668,314,159
潛在攤薄股份的影響		
購股權	34,772,932	25,900,283
用以計算每股攤薄盈利的加權平均股份數目	<u>2,803,023,572</u>	<u>2,694,214,442</u>

8. 應收賬款、按金及預付款項

本集團給予其貿易客戶的信貸期一般介乎30天至90天。已扣除減值虧損的應收貿易賬款（包括應收票據）的賬齡分析如下：

	於二零零七年 六月三十日 千港元	於二零零六年 十二月三十一日 千港元
0 – 60天	1,413,037	802,195
61 – 90天	360,896	176,328
91 – 180天	345,255	396,316
180天以上	25,647	120,200
	<u>2,144,835</u>	<u>1,495,039</u>

附註：應收賬款包括於本集團在日常業務進行的交易所產生應收關連公司款項的貿易應收賬款及應收票據合共169,437,000港元（二零零六年十二月三十一日：109,156,000港元）。有關款項為無抵押、免息及須於與本集團給予其其他主要客戶相若的信貸期內償還。

9. 應付賬款及應計費用

應付賬款及應計費用中包括的應付貿易賬款的賬齡分析如下：

	於二零零七年 六月三十日 千港元	於二零零六年 十二月三十一日 千港元
0 – 60天	1,108,911	729,403
61 – 90天	344,952	207,704
91 – 180天	482,529	411,069
180天以上	37,957	4,791
	<u>1,974,349</u>	<u>1,352,967</u>

10. 結算日後事項

於二零零七年六月二十一日，本公司及本公司的全資附屬公司 CRT (BVI) Limited 與華潤（集團）有限公司（「華潤集團」）的全資附屬公司 Gradison Limited 就按代價 1,170,000,000 港元出售華潤制冷科技有限公司（從事本集團壓縮機業務的控股公司）全部已發行股本（「出售事項」）訂立一份協議（「該協議」）。完成後，其錄得的出售收益將於下半年入賬，華潤制冷科技有限公司及其附屬公司將不再為本公司的附屬公司。該協議須待 (i) 本公司的獨立股東批准及 (ii) 本集團接獲於二零零七年三月十四日所簽訂的五年期最多 15 億港元的循環信貸 / 定期融資貸款協議中的大部分借款人發出有關該協議擬進行出售事項的同意書（「銀行同意書」）後方可完成。

結算日後，該協議於二零零七年七月三十日舉行的本公司股東特別大會上獲得本公司的獨立股東批准，而銀行同意書於二零零七年八月九日接獲。因此，出售事項已於二零零七年八月十六日完成。

中期業績審閱

截至二零零七年六月三十日止六個月的中期業績並未經審核，惟已經由本公司核數師及本公司審核委員會審閱。核數師的中期財務資料審閱報告載於將寄發予股東的中期報告內。

中期股息

董事議決於二零零七年十月九日向於二零零七年九月二十七日名列本公司股東登記名冊的股東派付截至二零零七年六月三十日止六個月的中期股息每股 1.00 港仙（截至二零零六年六月三十日止六個月：每股 1.00 港仙）。

暫停辦理股份過戶登記

本公司將於二零零七年九月二十一日起至二零零七年九月二十七日（包括首尾兩天）期間，暫停辦理股份過戶登記。為符合獲派建議中期股息的資格，填妥的過戶表格連同有關股票，最遲須於二零零七年九月二十日下午四時三十分前，交回本公司股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 28 號金鐘匯中心 26 樓。

業務回顧

於二零零七年上半年本集團半導體業務表現繼續改善，收益達 1,330,000,000 港元，較去年同期的 771,000,000 港元增加 72%，成功為本集團提供穩固的平台，為進一步開拓中華人民共和國（「中國」）龐大而增長迅速的半導體市場作好準備。

本集團壓縮機業務期內的表現未如理想，乃由於業內產能過剩及原材料成本上漲所致。

半導體業務

由於本集團半導體業務生產的集成電路產品壽命相對較長，屬於技術成熟的集成電路市場產品，並以中國為目標市場，比較以全球市場為目標的高端市場產品，價格波動相對輕微，半導體業務因而能夠維持穩定的毛利率。本集團將會繼續加強技術專長，為中國價格平穩但高速增長的集成電路市場生產更增值產品。本集團將繼續應用成功的業務模式，即使用成熟技術，從而以相對較低的資本開支進軍中國不斷發展的模擬集成電路和分立器件市場。

截至二零零七年六月三十日止期間，半導體業務營業額由上年同期錄得的 771,000,000 港元增加 72% 至 1,330,000,000 港元。營業額增加乃主要由於來自本集團於二零零六年七月收購半導體晶圓代工業務的營業額貢獻所致。期內的毛利率為 27%，與去年同期相若。預期於二零零七年剩餘時間及其後封測設備使用率上升後，毛利率將提升至更高水平。截至二零零七年六月三十日止期間，半導體業務的經營溢利為 147,000,000 港元（二零零六年：111,000,000 港元），增幅為 32%。

本集團現時為中國最大的半導體企業之一，其半導體業務包括：

集成電路設計業務

無錫華潤矽科微電子有限公司是中國大陸技術和規模領先的集成電路設計公司之一，該公司以數字和數模混合信號處理技術為主導，設計開發 MCU、音視頻處理 SoC 等半導體集成電路產品，廣泛應用於電視、音響、DVD 及 MP3 播放機、電子遊戲機、通訊設備和語音合成等電子消費產品。

近年新成立的華潤矽威科技（上海）有限公司及無錫華潤芯功率半導體設計有限公司從事電源管理集成電路和高壓分立器件的開發和設計，這些產品具有廣闊的市場前景。從二零零六年下半年起，此兩類產品已開始面市，相信將會對公司設計業務增長帶來積極的貢獻。

晶圓代工業務

華潤上華科技有限公司（「華潤上華」）是目前中國規模最大的 6 英寸晶圓代工企業，連同本集團於二零零四年新投資的一條 6 英寸晶圓生產線已逐步量產，本集團現擁有的 6 英寸晶圓代工總產能規模已相當可觀。公司合共擁有 3 條 6 英寸晶圓生產線，具備每月超過 10 萬片的 6 英寸晶圓代工能力及 0.35 微米功能，具備各種 MOS、雙極和 BICMOS，以及 DMOS 等工藝平台供客戶選擇。未來，本集團屬下 6 英寸晶圓代工將致力於向模擬產品代工轉型，以期達至更好的經營效益。

集成電路封測業務

本集團已與全球領先的集成電路封測代工企業 STATS ChipPAC Ltd. 合資設立無錫華潤安盛科技有限公司，該公司現亦是中國大陸專注集成電路封測代工業務的重點企業之一，主要面向世界知名的半導體廠商提供集成電路封測代工服務，有引線封裝測試技術處於國內領先地位，月封裝能力達到 25 億線。本公司持有該合資公司 75% 的股份。

作為對本集團集成電路封測業務的支持，賽美科微電子（深圳）有限公司已成為國內規模最大的晶圓中測代工商。

分立器件製造業務

無錫華潤華晶微電子有限公司是中國大陸功率型半導體分立器件開發和製造領域的標杆，該公司年產 4-6 英寸分立器件晶圓 1,500,000 片，是中國大陸分立器件芯片和成品的主要供應商。本集團設於香港的華潤半導體有限公司是中國光電晶體管系列產品的主要供應商。公司開發的上述分立器件產品應用於綠色照明、家用電器、工業控制儀器和個人計算機等領域。

壓縮機業務

本集團與合營企業夥伴日本三洋電機株式會社合作的壓縮機業務，是國內具領導地位的住宅空調壓縮機供應商之一。

隨著中國行業產能的增加，近年中國住宅空調壓縮機市場疲軟。原材料成本上漲使情況更進一步受壓。

於二零零七年上半年營業額為 1,122,000,000 港元，較二零零六年同期 866,000,000 港元增加 30%。然而，由於原材料成本持續上漲，毛利率由去年同期的 24% 減至 15%。不過，壓縮機業務繼續為本集團帶來經營溢利貢獻，但有關款額有所減少。其經營溢利率為 5%（二零零六年：16%）。是項業務於期內錄得經營溢利 56,000,000 港元，較二零零六年同期的 136,000,000 港元下降 58%。

重大投資、收購和出售事項

於二零零七年六月二十一日，本公司及本公司的全資附屬公司 CRT(BVI) Limited 與華潤集團（為本公司的主要兼控股股東）的全資附屬公司 Gradison Limited 訂立協議，以代價為 1,170,000,000 港元（「代價」）出售本集團壓縮機業務的控股公司華潤制冷科技有限公司（「華潤制冷」）的全部已發行股本（「出售事項」）。代價相等於本集團壓縮機業務於截至二零零六年十二月三十一日止年度應佔未經審核綜合除稅後純利約 20 倍，亦較本集團壓縮機業務於二零零六年十二月三十一日應佔未經審核綜合資產淨值高出約 10%。出售事項已於二零零七年八月十六日完成。

出售事項的出售所得款項將部份用作償還所欠債項，亦將用作投資於半導體業務及作為本集團營運資金所需。

前景

本集團將繼續致力透過內部增長、對外併購，努力尋求與海外和國內企業合組战略合作夥伴的機遇，繼續拓展本集團半導體業務。

在半導體業務方面，中國市場對模擬集成電路的需求急劇增長，本集團將可繼續從中受惠。本集團於二零零二年收購一家具領導地位的中國半導體企業以及其後成功進行重組及整合，為本集團創造了堅實的中國生產平台。為進一步鞏固本集團半導體生產平台及提升日後競爭力，本公司與 STATS ChipPAC Ltd.（世界主要的集成電路封裝及測試代工服務供應商之一）於二零零六年六月訂立合資協議，以拓展測試及封裝業務。

本集團的集成電路設計公司，為中國領先集成電路設計公司，於年內大幅擴大其模擬集成電路產品組合，並加強其設計能力。本集團於近年從美國引進一批高質素的半導體設計人才，並將繼續招攬海外受訓的半導體專才，以提升本集團持續發展集成電路和分立器件的設計及生產的能力。

本集團經營晶圓代工業務的聯營公司華潤上華曾進行重組、集資及引進戰略性夥伴，以及其後於二零零四年在聯交所上市，為本集團晶圓代工業務的迅速擴展鋪路。本集團於二零零六年七月收購華潤上華的控制性權益，使本集團晉升為中國最大半導體企業之一。本集團經已晉身為中國技術成熟集成電路的翹楚，在製造和封裝模擬集成電路及分立器件、經營集成電路設計、提供晶圓代工服務技術方面享有舉足輕重的地位。

本集團半導體業務已成為本集團的主要增長動力，為本集團提供穩固平台，以進軍中國日益擴展的龐大半導體市場。本集團預期在二零零七年的總收益當中，半導體業務的收益貢獻將佔有相當比重。本集團於二零零七年上半年斥資 331,000,000 港元，以購買更多半導體生產設備。本集團將繼續致力招攬優秀專才、與外國夥伴結成戰略聯盟和科技聯盟，務求持續提升本身在模擬集成電路和分立器件市場中的技術實力。

受惠於中國半導體市場的雙位數字增長，近年本集團的半導體業務急速擴張。預期該趨勢於可預見將來仍會持續。相反，由於壓縮機行業產能過剩，加上原材料成本上漲，近年本集團的空調壓縮機業務的毛利率及盈利能力迅速被削弱。與半導體業務相比，壓縮機業務對本集團的貢獻持續減少。本集團於二零零七年六月二十一日宣佈出售其壓縮機業務，以專注發展半導體業務。

本集團正不斷努力出售非核心業務，近年經已先後出售資訊科技及辦公室傢俱業務。出售壓縮機業務乃本集團在此方面的延伸。出售壓縮機業務後，本集團將成為單一業務實體，可集中資源發展增長迅速的半導體業務。

購回、出售或贖回本公司之上市證券

截至二零零七年六月三十日止期間，本公司或其任何附屬公司概無購回、出售或贖回本公司任何股份。

遵守企業管治常規守則及標準守則

本公司在期內一直遵守上市規則附錄 14 所載企業管治常規守則之規定。

本公司已採納上市規則附錄 10 所載標準守則為董事進行證券交易之行為守則（「守則」）。經向全體董事作出特定查詢後，本公司確認，全體董事均已遵守守則所載規定標準。

中期報告

二零零七年中期報告將於適當時候寄發予股東及在聯交所網站（www.hkex.com.hk）及本公司網站（www.crlogic.com.hk）刊載。

承董事會命
華潤勵致有限公司
朱金坤
主席

香港，二零零七年八月二十三日

於本公告日期，本公司的董事如下：

執行董事 ： 朱金坤先生、王國平先生、王添根先生及陳正宇先生

非執行董事 ： 蔣偉先生、劉燕杰先生及李福祚先生

獨立非執行董事 ： 黃得勝先生、陸志昌先生、高秉強先生及楊崇和先生